

スパッタリング装置

ES-830



■概要■

本システムは、300mm×400mmの大面積用スパッタリング装置です。
8インチのスパッタ源による、3元のスパッタリングが可能です。
ターゲット、基板間の間隔は連続して可変調整できます。

■仕様■

<スパッタ室>

到達圧力	10 ⁻⁵ Pa台	排気系	TMP+RP
基板寸法	300mm×400mm	オプション	成膜ソフト
基板加熱温度	Max 700℃			

<スパッタ源>

ターゲット寸法	φ8インチ
ターゲット数	3基
RF電源	3kW (オートマッチャー付)